【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和6年8月7日(2024.8.7)

【国際公開番号】WO2023/100923
【出願番号】特願2023-565045(P2023-565045)
【国際特許分類】
Ｈ０５Ｋ　9/00(2006.01)
Ｃ０１Ｂ 32/184(2017.01)
Ｃ０８Ｋ　7/24(2006.01)
Ｃ０８Ｌ 63/00(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０５Ｋ　9/00　　Ｍ
Ｃ０１Ｂ 32/184
Ｃ０８Ｋ　7/24
Ｃ０８Ｌ 63/00　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和6年5月23日(2024.5.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
有機物及び無機物から選ばれる少なくとも１種を含む母材と、粉末炭素材料とを含む電磁干渉抑制材料であって、
前記粉末炭素材料は、１個の孔を有する中空粒子である第１の殻状体、及び中空粒子が連結した形状であって複数の孔を有する第２の殻状体から選ばれる少なくとも１種であり、
前記第１の殻状体及び前記第２の殻状体の殻部は、平均層数が４以下のグラフェンからなる、電磁干渉抑制材料。
【請求項２】
前記粉末炭素材料の比表面積が１３００ｍ^2／ｇ以上である、請求項１に記載の電磁干渉抑制材料。
【請求項３】
前記第１の殻状体が有する孔及び前記第２の殻状体が有する孔の容積が、１．３ｃｃ／ｇ以上である、請求項１又は２に記載の電磁干渉抑制材料。
【請求項４】
体積抵抗が１０^{3}Ω・ｃｍ以上である、請求項１又は２に記載の電磁干渉抑制材料。
【請求項５】
前記粉末炭素材料の平均粒径が２００μｍ以下である、請求項１又は２に記載の電磁干渉抑制材料。
【請求項６】
前記有機物がエポキシ樹脂である、請求項１又は２に記載の電磁干渉抑制材料。
【請求項７】
前記無機物が、セラミックスである、請求項１又は２に記載の電磁干渉抑制材料。
【請求項８】
前記有機物又は前記無機物が発泡体である、請求項１又は２に記載の電磁干渉抑制材料

。
【請求項９】
前記粉末炭素材料の含有量が０．０１～９５質量％である、請求項１又は２に記載の電磁干渉抑制材料。
【請求項１０】
前記有機物又は前記無機物から選ばれる少なくとも１種を含む母材の表面に前記粉末炭素材料が存在する、請求項１又は２に記載の電磁干渉抑制材料。
【請求項１１】
請求項１又は２に記載の電磁干渉抑制材料を含む、半導体素子封止材。